

SN74AHC595-Q1 車載用、3 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット シフトレジスタ

1 特長

- 車載アプリケーション認定済み
- 2V~5.5V の V_{CC} で動作
- 8 ビットのシリアル イン / パラレル アウト シフト
- シフトレジスタはダイレクト クリアを装備

2 アプリケーション

- デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
- インジケータ LED の制御
- 通信モジュールとシステム・コントローラのためのレベル変換

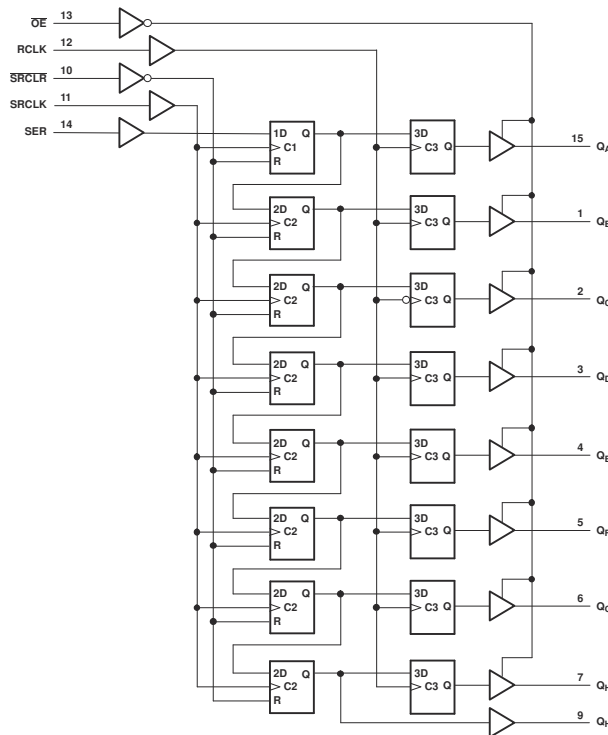
3 概要

SN74AHC595 には、8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフトレジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプストレージレジスタへデータを供給します。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN74AHC595-Q1	BQB (WQFN, 16)	3.5mm × 2.5mm	3.5mm × 2.5mm
	PW (TSSOP, 16)	5.00mm × 6.40mm	5.00mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)



Table of Contents

1 特長	1	7.1 Overview.....	9
2 アプリケーション	1	7.2 Functional Block Diagram.....	9
3 概要	1	7.3 Device Functional Modes.....	10
4 Pin Configuration and Functions	3	8 Application and Implementation	11
5 Specifications	4	8.1 Power Supply Recommendations.....	11
5.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8.2 Layout.....	11
5.2 Recommended Operating Conditions.....	4	9 Device and Documentation Support	12
5.3 Thermal Information.....	4	9.1 Document Support (Analog).....	12
5.4 Electrical Characteristics.....	5	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	12
5.5 Timing Requirements, $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	5	9.3 サポート・リソース.....	12
5.6 Timing Requirements, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	5	9.4 Trademarks.....	12
5.7 Timing Diagrams	6	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	12
5.8 Switching Characteristics, $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	7	9.6 用語集.....	12
5.9 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	7	10 Revision History	12
6 Parameter Measurement Information	8	11 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	13
7 Detailed Description	9		

4 Pin Configuration and Functions

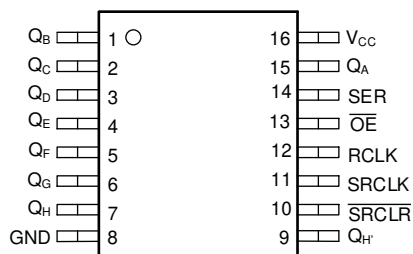


図 4-1. PW Package, 16-PIN TSSOP (Top View)

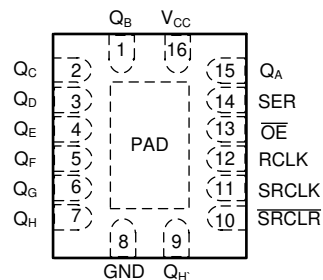


図 4-2. BQB Package, 16-Pin WQFN (Top View)

表 4-1. Pin Functions

PIN		TYPE ⁽¹⁾	DESCRIPTION
NAME	NO.		
Q _B	1	O	Q _B Output
Q _C	2	O	Q _C Output
Q _D	3	O	Q _D Output
Q _E	4	O	Q _E Output
Q _F	5	O	Q _F Output
Q _G	6	O	Q _G Output
Q _H	7	O	Q _H Output
GND	8	G	Ground Pin
Q _{H'}	9	O	Q _{H'} Output
SRCLR	10	I	SRCLR Input
SRCLK	11	I	SRCLK Input
RCLK	12	I	RCLK Input
OE	13	I	Output Enable Pin. Active LOW
SER	14	I	SER Input
Q _A	15	O	Q _A Output
V _{CC}	16	P	Power Pin

(1) I = Input, O = Output, I/O = Input or Output, G = Ground, P = Power

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range	−0.5	7	V
V _I	Input voltage range ⁽²⁾	−0.5	7	V
V _O	Output voltage range ⁽²⁾	−0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	Input clamp current (V _I < 0)		−20 mA	mA
I _{OK}	Output clamp current (V _O < 0 or V _O > V _{CC})		±20 mA	mA
I _O	Continuous output current (V _O = 0 to V _{CC})		±25 mA	mA
	Continuous current through V _{CC} or GND		±75 mA	mA
T _{stg}	Storage temperature range	−65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under *absolute maximum ratings* may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under *recommended operating conditions* is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

5.2 Recommended Operating Conditions

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage	2	5.5	V
V _{IH}	High-level input voltage	V _{CC} = 2 V	1.5	V
		V _{CC} = 3 V	2.1	
		V _{CC} = 5.5 V	3.85	
V _{IL}	Low-level input voltage	V _{CC} = 2 V	0.5	V
		V _{CC} = 3 V	0.9	
		V _{CC} = 5.5 V	1.65	
V _I	Input voltage	0	5.5	V
V _O	Output voltage	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High-level output current	V _{CC} = 2 V	−50	μA
		V _{CC} = 3.3 V ± 0.3 V	−4	mA
		V _{CC} = 5 V ± 0.5 V	−8	
I _{OL}	Low-level output current	V _{CC} = 2 V	50	μA
		V _{CC} = 3.3 V ± 0.3 V	4	mA
		V _{CC} = 5 V ± 0.5 V	8	
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate	V _{CC} = 3.3 V ± 0.3 V	100	ns/V
		V _{CC} = 5 V ± 0.5 V	20	
T _A	Operating free-air temperature	I-suffix devices	−40	°C
		Q-suffix devices	−40	

- (1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number [SCBA004](#).

5.3 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾	BQB (WQFN)	PW (TSSOP)	UNIT
	16 PINS	16 PINS	
R _{θJA} Junction-to-ambient thermal resistance	91.8	135.9	°C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the *IC Package Thermal Metrics* application report ([SPRA953](#)).

5.4 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	V _{CC}	T _A = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
V _{OH}	I _{OH} = –50 µA	2 V	1.9	2		1.9		V
		3 V	2.9	3		2.9		
		4.5 V	4.4	4.5		4.4		
	I _{OH} = –4 mA	3 V	2.58			2.48		
	I _{OH} = –8 mA	4.5 V	3.94			3.8		
V _{OL}	I _{OL} = 50 µA	2 V			0.1		0.1	V
		3 V			0.1		0.1	
		4.5 V			0.1		0.1	
	I _{OL} = 4 mA	3 V			0.36		0.44	
	I _{OL} = 8 mA	4.5 V			0.36		0.44	
I _I	V _I = 5.5 V or GND	0 V to 5.5 V			±0.1		±1	µA
I _{OZ}	Q _A –Q _H , V _I = V _{CC} or GND, V _O = V _{CC} or GND, $\overline{\text{OE}}$ = V _{IH} or V _{IL}	5.5 V			±0.25		±10	µA
I _{CC}	V _I = V _{CC} or GND, I _O = 0	5.5 V			4		40	µA
C _i	V _I = V _{CC} or GND	5 V		3	10		10	pF
C _o	V _O = V _{CC} or GND	5 V		5.5				pF

5.5 Timing Requirements, V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V

V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

			T _A = 25°C		MIN	MAX	UNIT
			MIN	MAX			
t _w	Pulse duration	SRCLK high or low	5.5		6.5		ns
		RCLK high or low	5.5		6.5		
		SRCLR low	5		6		
t _{su}	Setup time	SER before SRCLK ↑	3.5		4.5		ns
		SRCLK ↑ before RCLK ↑ ⁽¹⁾	8		9.5		
		SRCLR low before RCLK ↑	8		10		
		SRCLR high (inactive) before SRCLK ↑	3		4		
t _h	Hold time	SER after SRCLK ↑	1.5		2.5		ns

- (1) This setup time allows the storage register to receive stable data from the shift register. The clocks can be tied together, in which case the shift register is one clock pulse ahead of the storage register.

5.6 Timing Requirements, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V

V_{CC} = 5 V ± 0.5 V, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

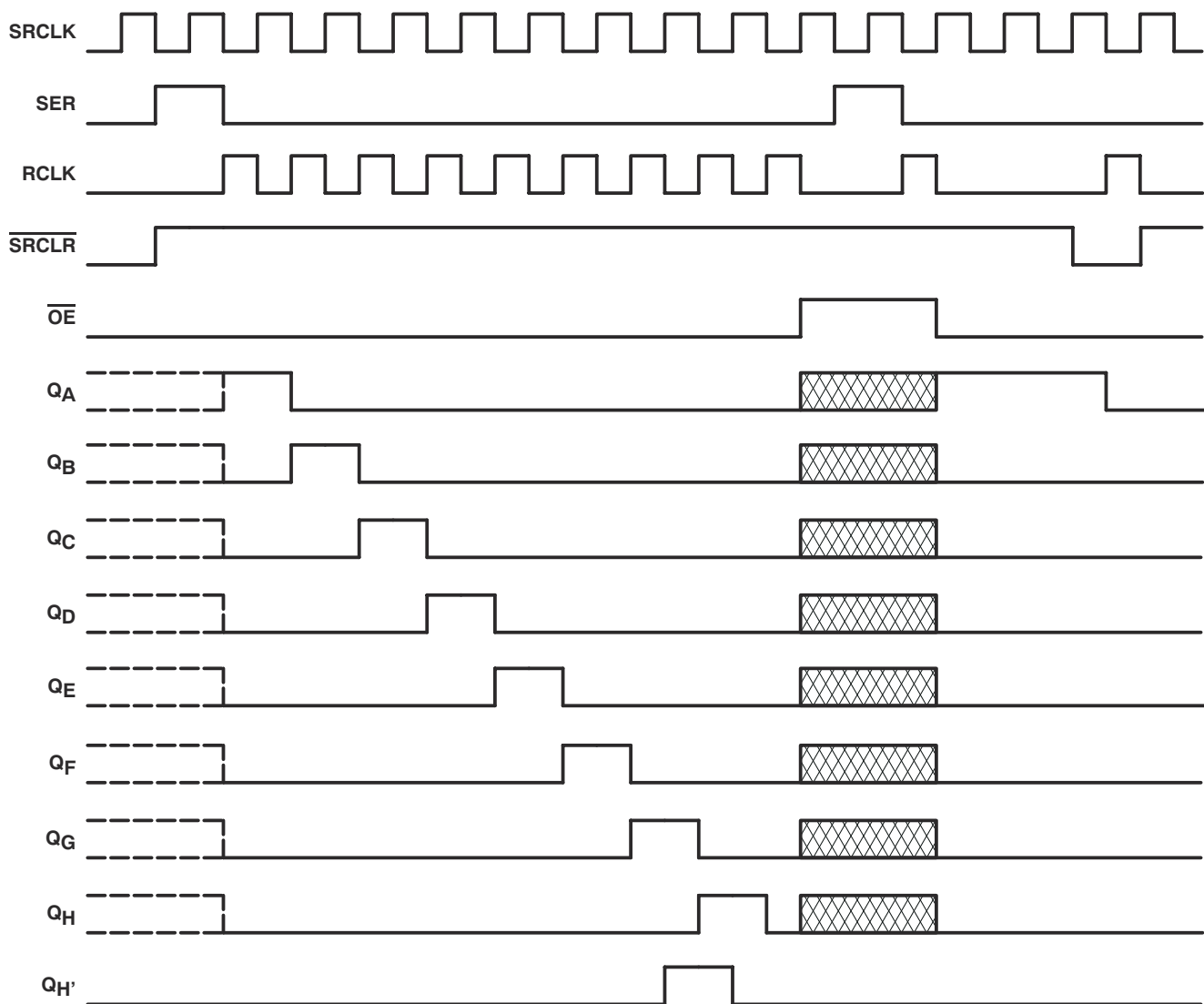
			T _A = 25°C		MIN	MAX	UNIT
			MIN	MAX			
t _w	Pulse duration	SRCLK high or low	5		6		ns
		RCLK high or low	5		6		
		SRCLR low	5.2		6.2		

$V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

		$T_A = 25^\circ\text{C}$		MIN	MAX	UNIT
		MIN	MAX			
t_{su} Setup time	SER before SRCLK $\uparrow$	3		4		ns
	SRCLK $\uparrow$ before RCLK $\uparrow$ ⁽¹⁾	5		6		
	SRCLR low before RCLK $\uparrow$	5		6		
	SRCLR high (inactive) before SRCLK $\uparrow$	2.5		3.5		
t_h Hold time	SER after SRCLK $\uparrow$	2		3		ns

(1) This setup time allows the storage register to receive stable data from the shift register. The clocks can be tied together, in which case the shift register is one clock pulse ahead of the storage register.

5.7 Timing Diagrams



NOTE:  implies that the output is in 3-State mode.

5.8 Switching Characteristics, $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$

$V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

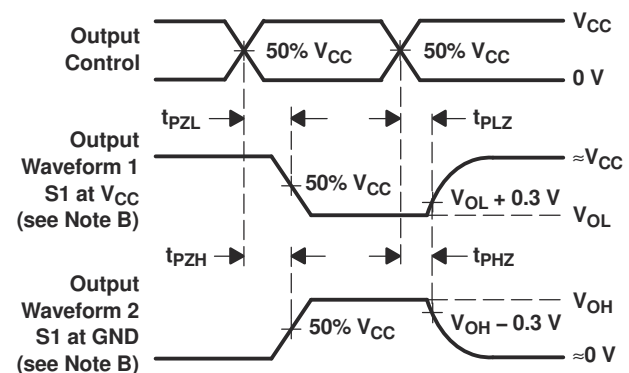
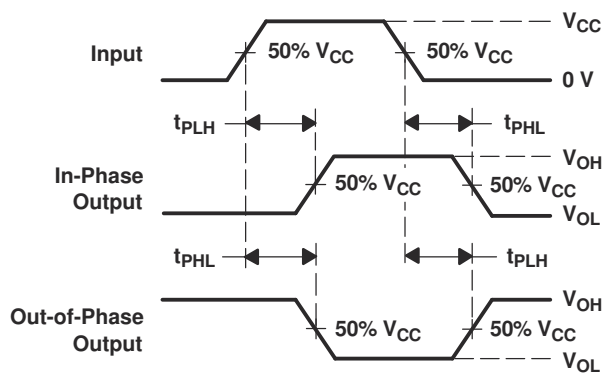
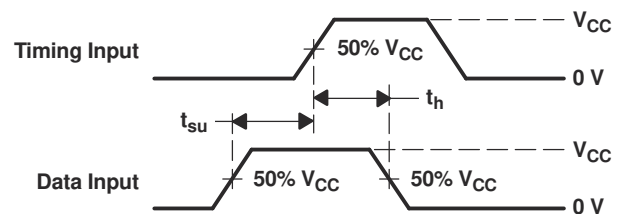
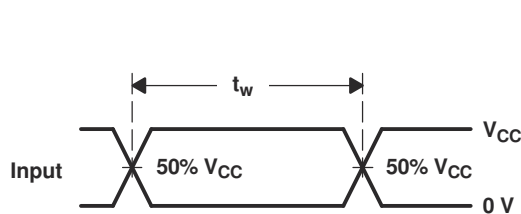
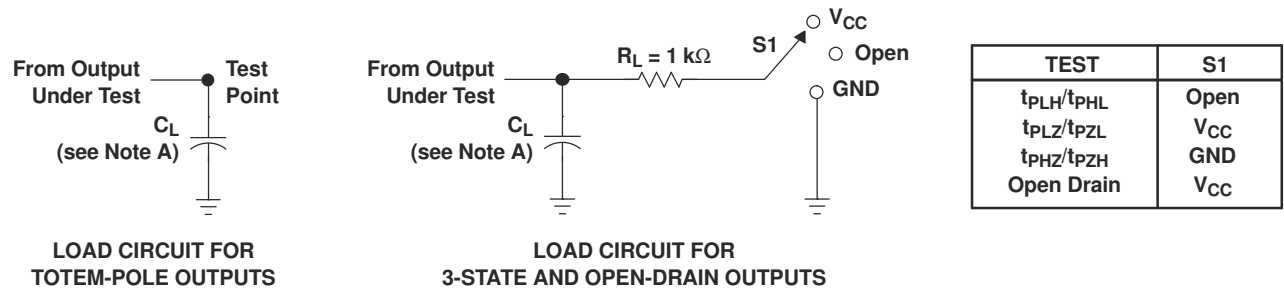
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	LOAD CAPACITANCE	$T_A = 25^\circ\text{C}$			MIN	MAX	UNIT
				MIN	TYP	MAX			
$f_{\max}$			$C_L = 50\text{ pF}$	55	105		40		MHz
t_{PLH}	RCLK	Q_A-Q_H	$C_L = 50\text{ pF}$		7.9	15.4	1	20	ns
t_{PHL}					7.9	15.4	1	20	
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	$C_L = 50\text{ pF}$		9.2	16.5	1	21.5	ns
t_{PHL}					9.2	16.5	1	21.5	
t_{PHL}	$\overline{\text{SRCLR}}$	$Q_{H'}$	$C_L = 50\text{ pF}$		9	16.3	1	20.2	ns
t_{PZH}	$\overline{\text{OE}}$	Q_A-Q_H	$C_L = 50\text{ pF}$		7.8	15	1	20	ns
t_{PZL}					9.6	15	1	20	
t_{PHZ}	$\overline{\text{OE}}$	Q_A-Q_H	$C_L = 50\text{ pF}$		8.1	15.7	1	19.2	ns
t_{PLZ}					9.3	15.7	1	19.2	

5.9 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$

$V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	LOAD CAPACITANCE	$T_A = 25^\circ\text{C}$			MIN	MAX	UNIT
				MIN	TYP	MAX			
$f_{\max}$			$C_L = 50\text{ pF}$	95	140		75		MHz
t_{PLH}	RCLK	Q_A-Q_H	$C_L = 50\text{ pF}$		5.6	9.4	1	13.5	ns
t_{PHL}					5.6	9.4	1	13.5	
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	$C_L = 50\text{ pF}$		6.4	10.2	1	14.4	ns
t_{PHL}					6.4	10.2	1	14.4	
t_{PHL}	$\overline{\text{SRCLR}}$	$Q_{H'}$	$C_L = 50\text{ pF}$		6.4	10	1	14.1	ns
t_{PZH}	$\overline{\text{OE}}$	Q_A-Q_H	$C_L = 50\text{ pF}$		5.7	10.6	1	15	ns
t_{PZL}					6.8	10.6	1	15	
t_{PHZ}	$\overline{\text{OE}}$	Q_A-Q_H	$C_L = 50\text{ pF}$		3.5	10.3	1	14	ns
t_{PLZ}					3.4	10.3	1	14	

6 Parameter Measurement Information



- NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
 B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
 C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 1$ MHz, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r \leq 3$ ns, $t_f \leq 3$ ns.
 D. The outputs are measured one at a time, with one input transition per measurement.

6-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

7 Detailed Description

7.1 Overview

The SN74AHC595 contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage registers.

The shift register has a direct overriding clear ($\overline{\text{SRCLR}}$) input, serial (SER) input, and a serial output for cascading. When the output-enable ($\overline{\text{OE}}$) input is high, all outputs, except QH' , are in the high-impedance state.

Both the shift-register clock (SRCLK) and storage-register clock (RCLK) are positive-edge triggered. If both clocks are connected together, the shift register always is one clock pulse ahead of the storage register.

7.2 Functional Block Diagram

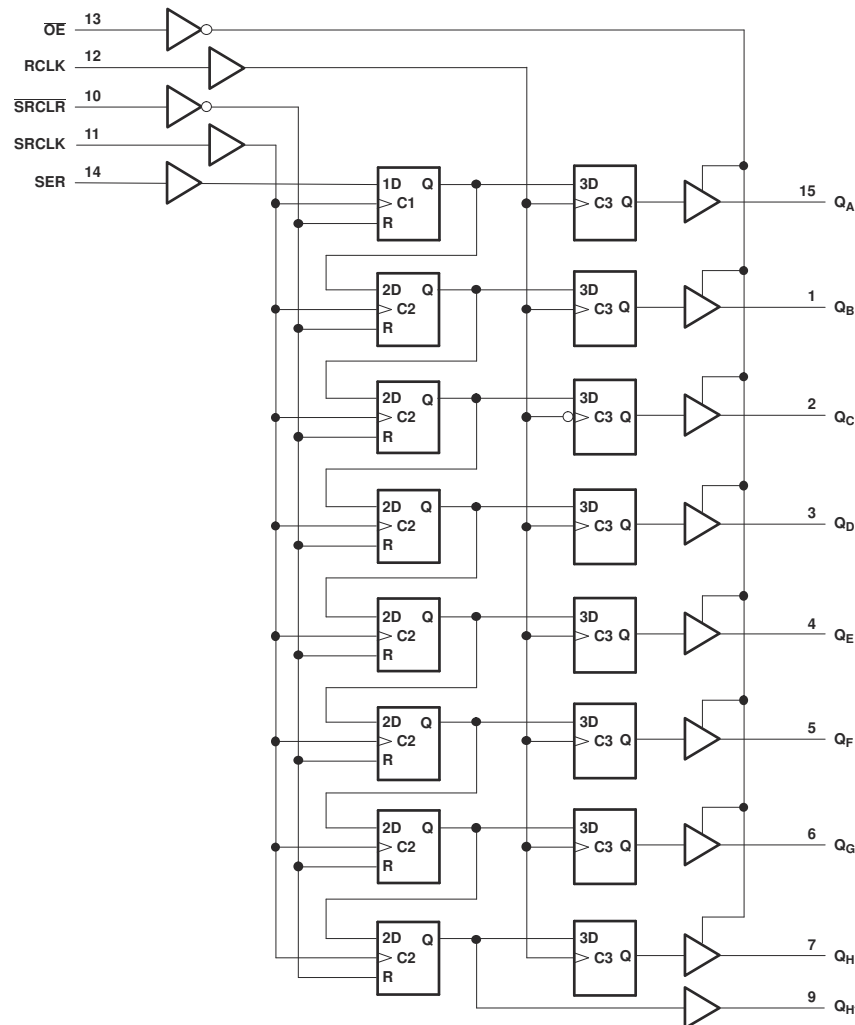


図 7-1. Logic Diagram (Positive Logic)

7.3 Device Functional Modes

表 7-1. Function Table

INPUTS					FUNCTION
SER	SRCLK	SRCLR	RCLK	OE	
X	X	X	X	H	Outputs Q _A –Q _H are disabled.
X	X	X	X	L	Outputs Q _A –Q _H are enabled.
X	X	L	X	X	Shift register is cleared.
L	↑	H	X	X	First stage of the shift register goes low. Other stages store the data of previous stage, respectively.
H	↑	H	X	X	First stage of the shift register goes high. Other stages store the data of previous stage, respectively.
X	X	X	↑	X	Shift-register data is stored into the storage register.

8 Application and Implementation

注

Information in the following applications sections is not part of the TI component specification, and TI does not warrant its accuracy or completeness. TI's customers are responsible for determining suitability of components for their purposes, as well as validating and testing their design implementation to confirm system functionality.

8.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the minimum and maximum supply voltage rating located in the *Recommended Operating Conditions*. Each V_{CC} terminal should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. A 0.1- μ F capacitor is recommended for this device. It is acceptable to parallel multiple bypass capacitors to reject different frequencies of noise. The 0.1- μ F and 1- μ F capacitors are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power terminal as possible for best results, as shown in the following layout example.

8.2 Layout

8.2.1 Layout Guidelines

When using multiple-input and multiple-channel logic devices, inputs must never be left floating. In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused (for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only 3 of the 4 buffer gates are used). Such unused input pins must not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a logic high or logic low voltage, as defined by the input voltage specifications, to prevent them from floating. The logic level that must be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally, the inputs are tied to GND or V_{CC} , whichever makes more sense for the logic function or is more convenient.

8.2.2 Layout Example

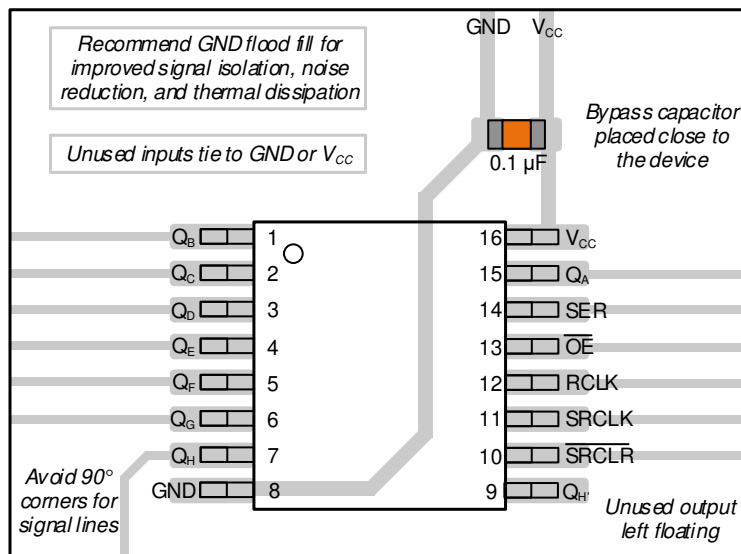


図 8-1. Example Layout for the SN74AHC595-Q1

9 Device and Documentation Support

9.1 Document Support (Analog)

9.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 9-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
SN74AHC595-Q1	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (March 2024) to Revision E (April 2024) Page

- Updated thermal values for PW package from RθJA = 108 to 135.9, all values in °C/W **4**

Changes from Revision C (November 2023) to Revision D (March 2024) Page

- 「パッケージ情報」表、「ピン構成および機能」セクション、「熱に関する情報」表に BQB パッケージを追加..... **1**

11 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74AHC595QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HA595Q
SN74AHC595QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HA595Q
SN74AHC595QWBQBRQ1	Active	Production	WQFN (BQB) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AH595Q
SN74AHC595QWBQBRQ1.A	Active	Production	WQFN (BQB) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AH595Q

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

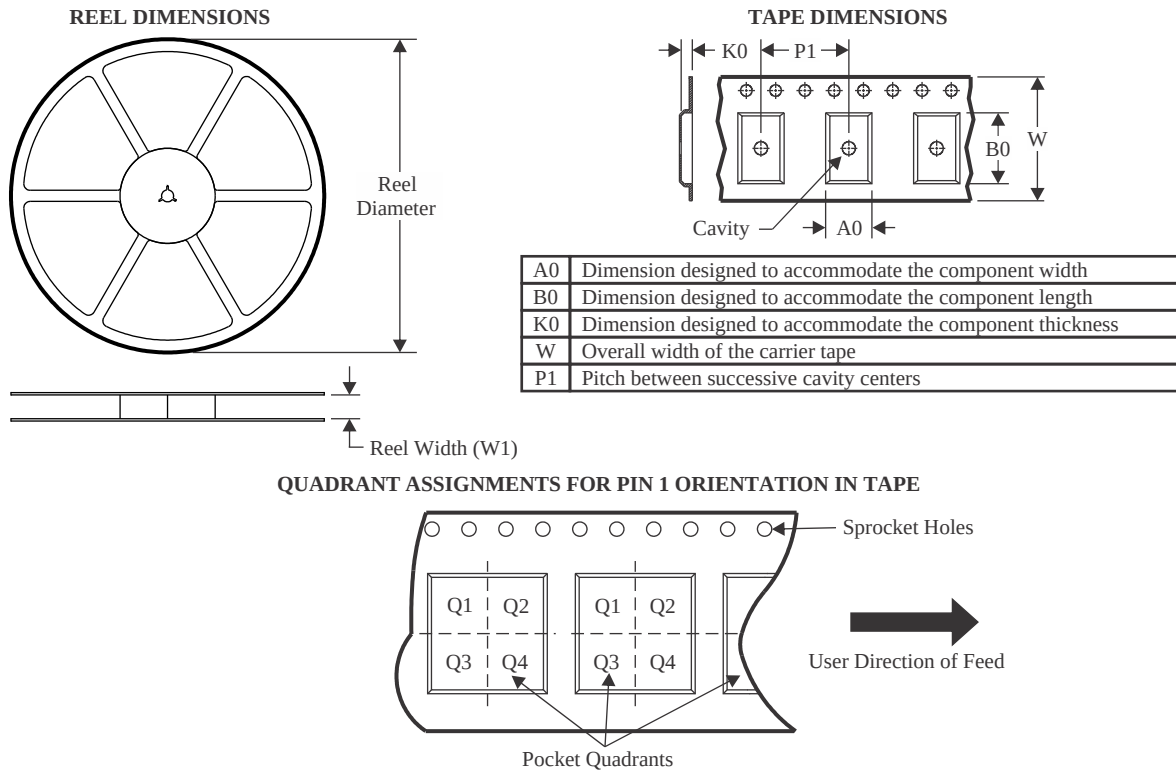
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHC595-Q1 :

- Catalog : [SN74AHC595](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

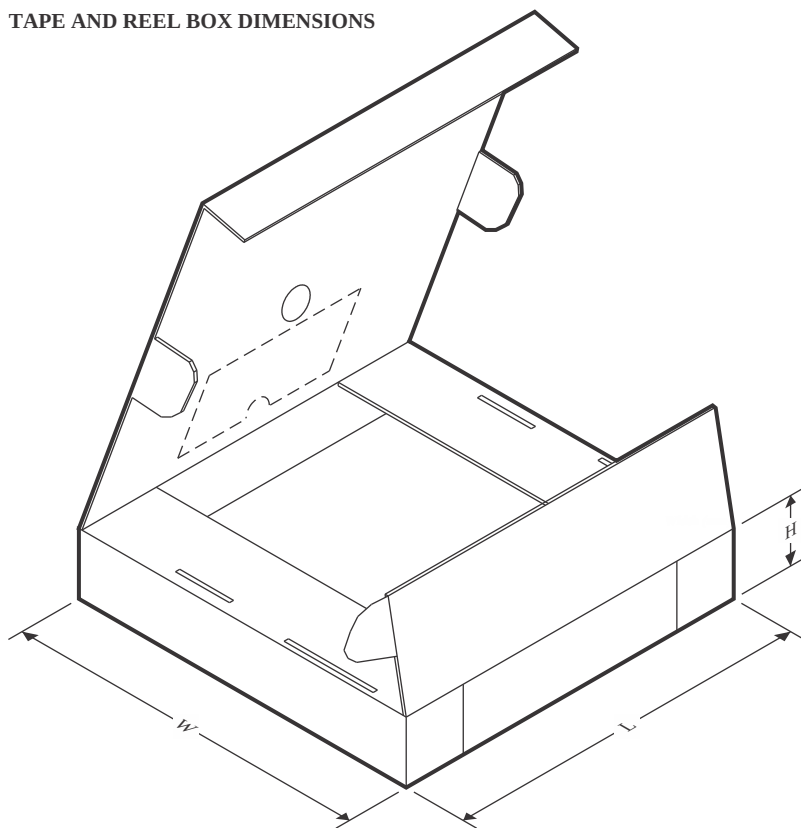
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74AHC595QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHC595QWBQBRQ1	WQFN	BQB	16	3000	180.0	12.4	2.8	3.8	1.2	4.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74AHC595QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AHC595QWBQRQ1	WQFN	BQB	16	3000	210.0	185.0	35.0

GENERIC PACKAGE VIEW

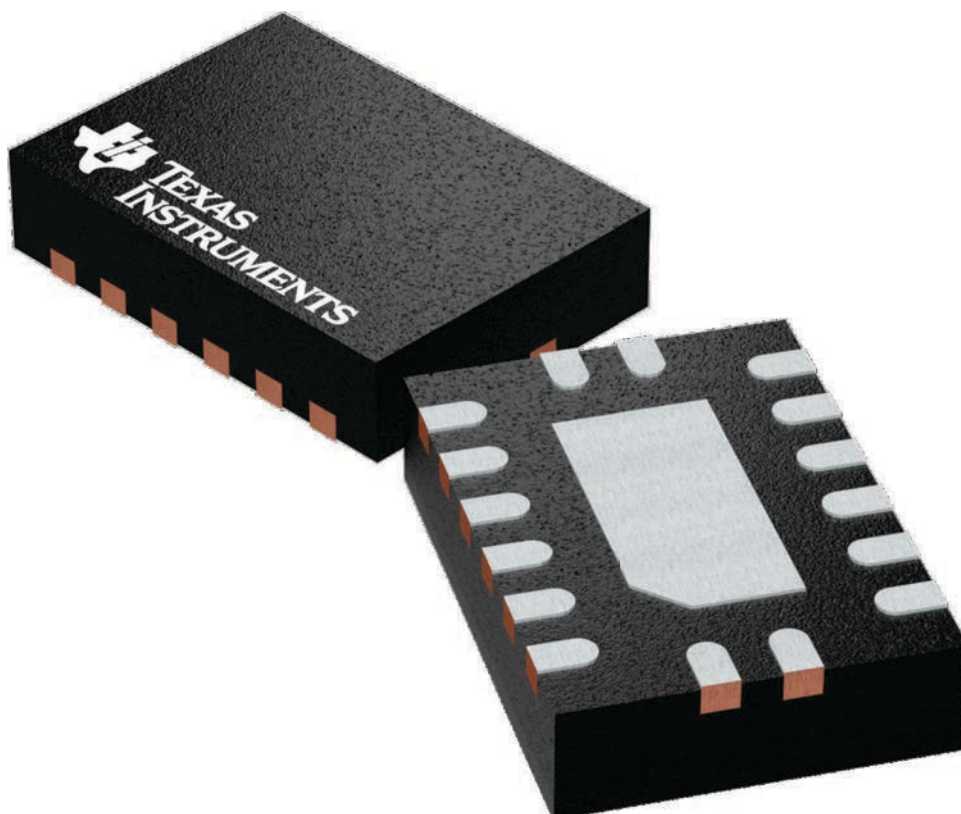
BQB 16

WQFN - 0.8 mm max height

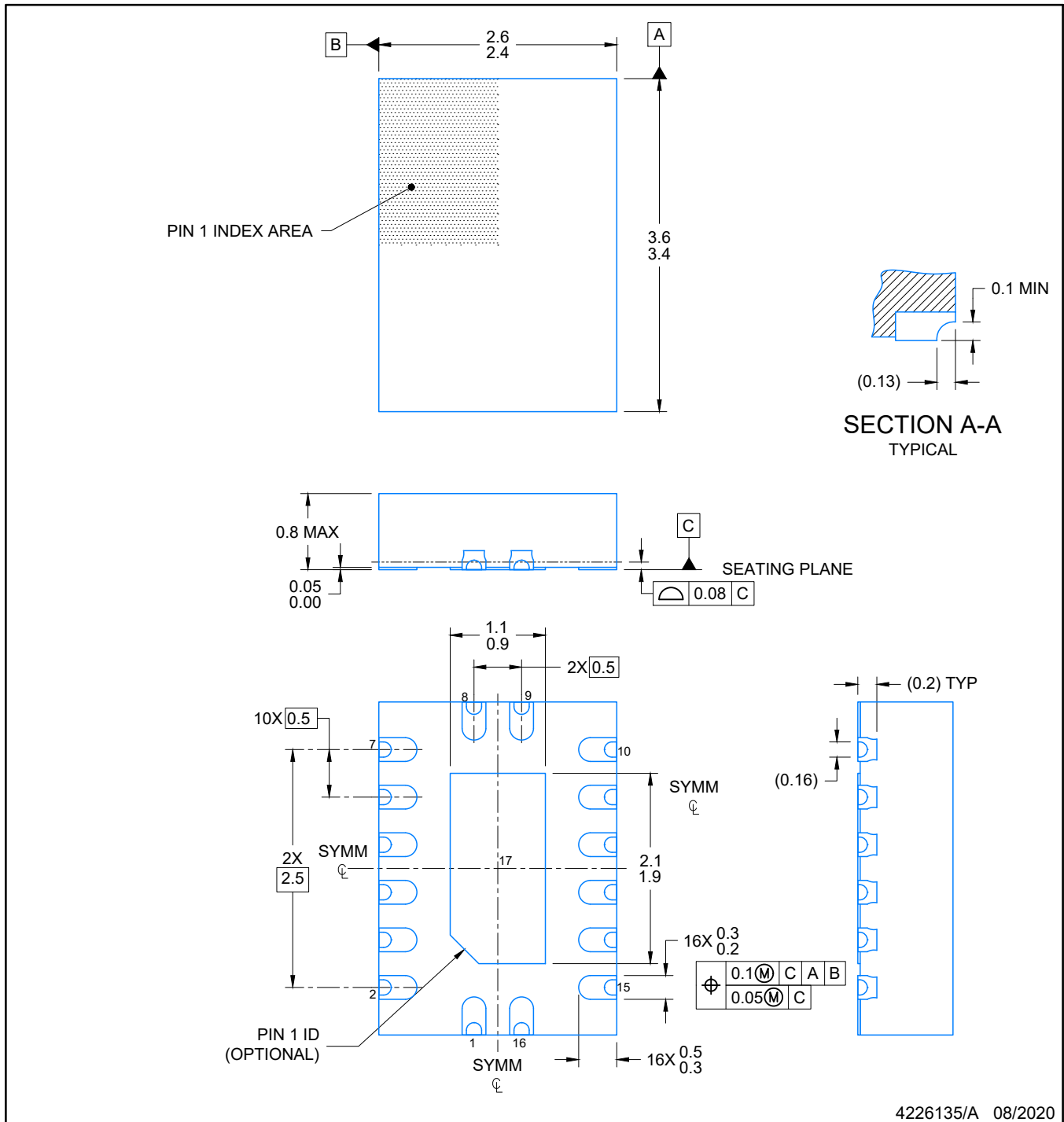
2.5 x 3.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

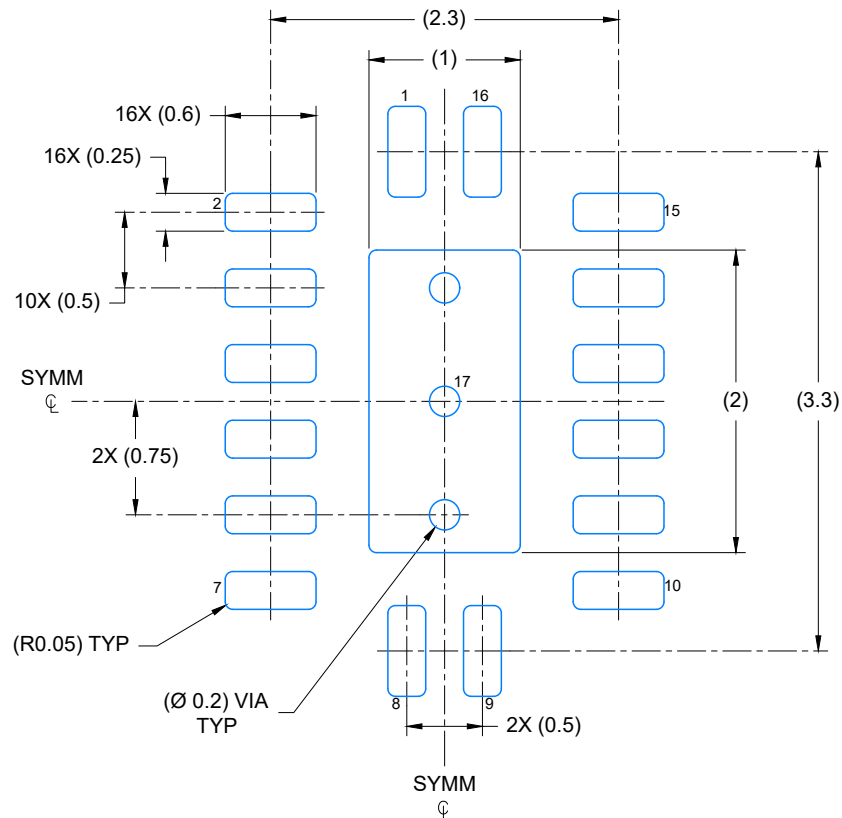


4226161/A



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

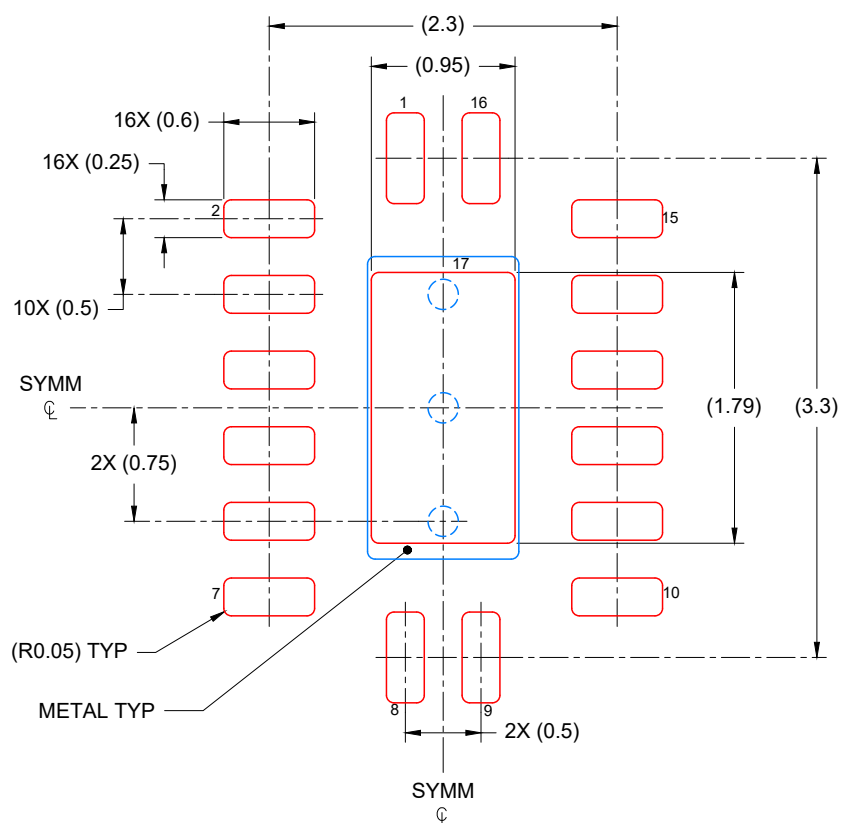


LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



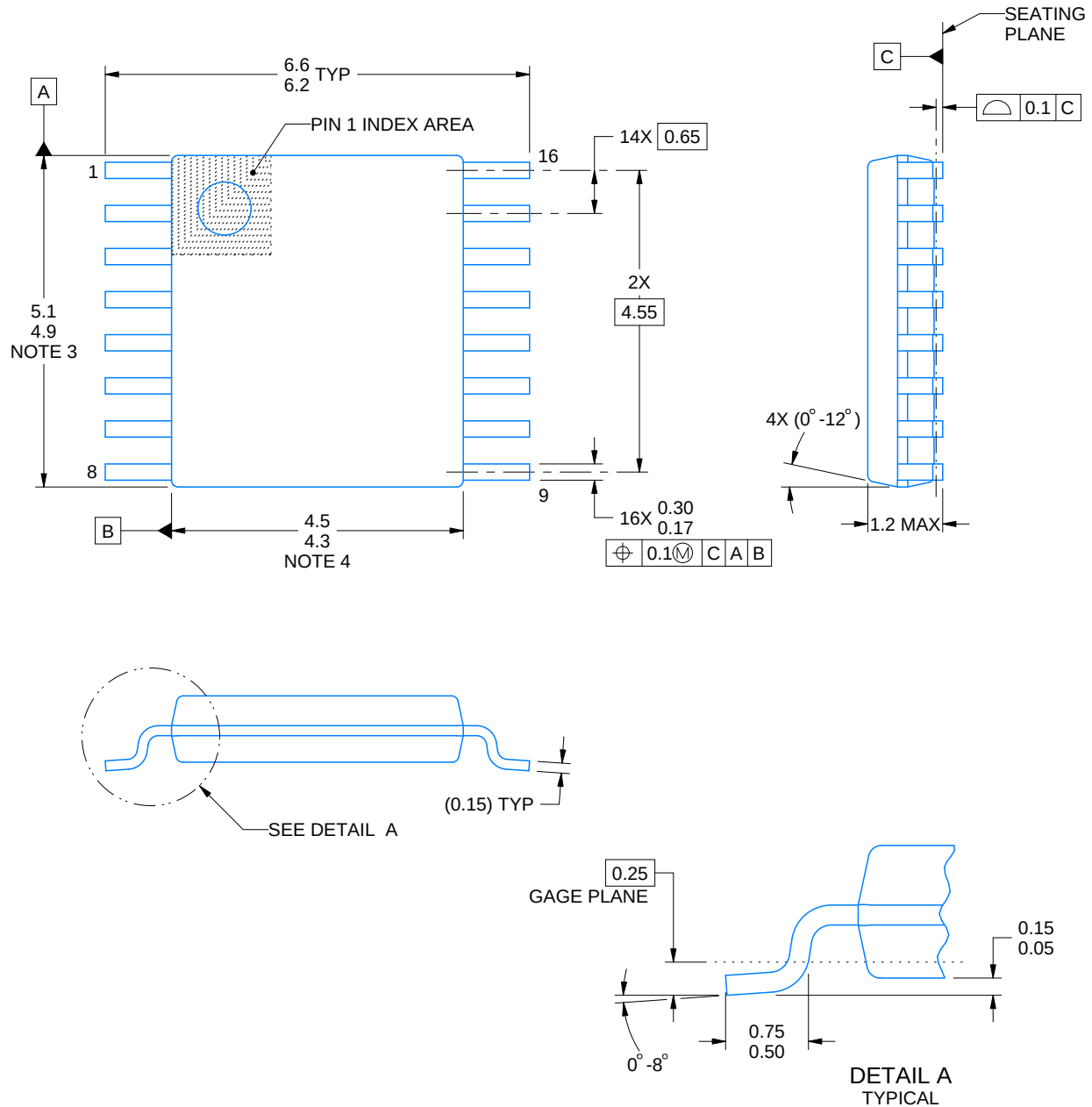
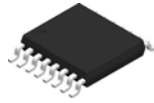
SOLDER PASTE EXAMPLE BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
85% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



4220204/B 12/2023

NOTES:

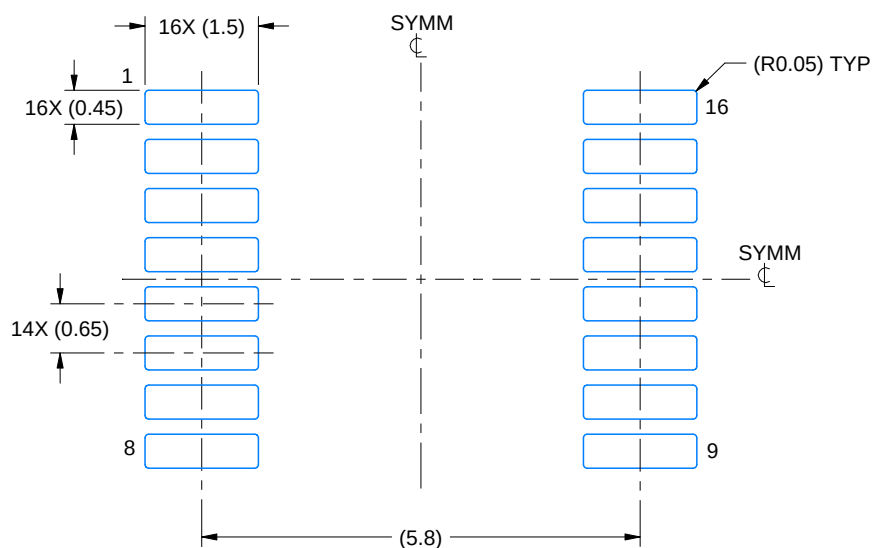
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

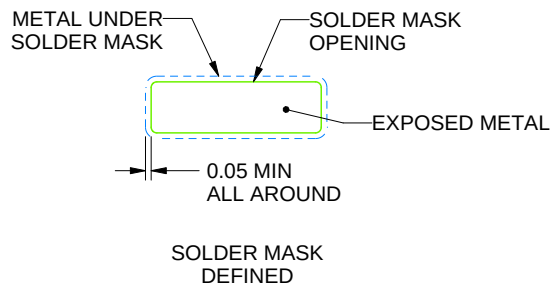
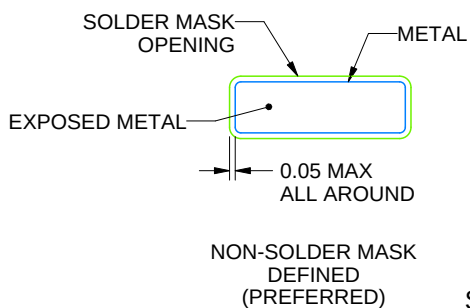
PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

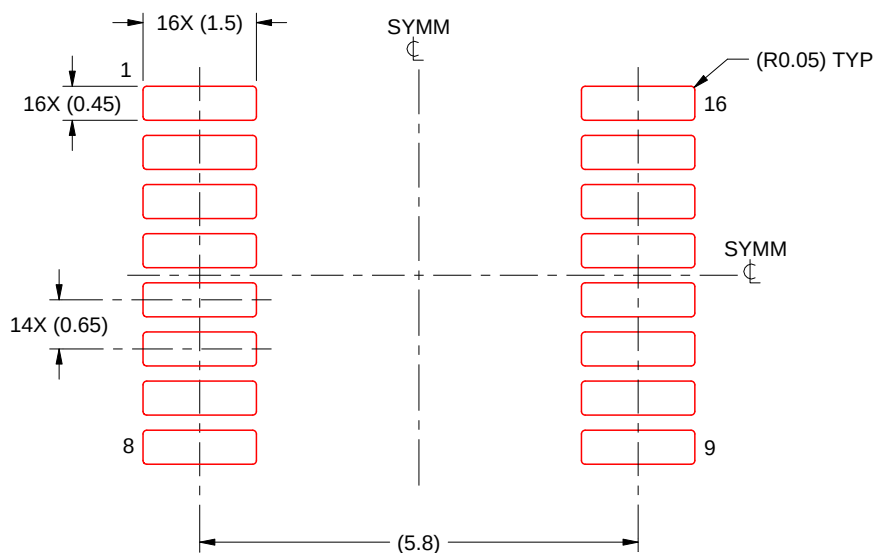
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月